

\* NOTICES \*

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. \*\*\*\* shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

---

## DETAILED DESCRIPTION

---

### [Detailed Description of the Invention]

#### [0001]

[Industrial Application] Especially this invention relates to the manufacture method of the liquid crystal device which has a thin glass substrate about the manufacture method of a liquid crystal device.

#### [0002]

[Description of the Prior Art] The composition of a liquid crystal display element is shown in drawing 1. Here, it is a perspective diagram, (b) is a cross section, and (a) expands and shows the portion of a liquid crystal layer in (b). As shown in this drawing, a liquid crystal display element encloses liquid crystal 12 among glass substrates 10 and 11, and has composition which attached polarizing plates 13 and 14 to the outside of glass substrates 10 and 11. 15 is the seal given by methods, such as screen-stencil, in order to enclose liquid crystal into a container. The thickness of the aforementioned glass substrates 10 and 11 is usual, respectively. Even if it is about 1.1mm, and liquid crystal 12 is so thin that it can generally be disregarded and it sets this and polarizing plates 13 and 14 It is about 0.4-0.5mm. Therefore, it is set to the thickness T1 of a liquid crystal display element, and about 2.6mm. Although various devices using the liquid crystal display element as display are supplied these days, the demand of lightweight-izing of the request of the formation of small lightweight of those devices to a liquid crystal display, as a result a liquid crystal display element or thin-shape-izing is becoming strong. Lightweight-izing and thin-shape-izing of this liquid crystal display element are realizable by making thickness of the glass of a glass substrate small. Conventionally, manufacture of this thin shape liquid crystal display element was performed from the manufacture start point in time using the thin glass plate. With the thickness of the glass plate at this time, about 0.7mm, and a still thinner thing The about 0.3mm thing is also used.

#### [0003]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] However, handling will be difficult for a thin glass plate, and the restrictions to the manufacturing installation of a liquid crystal display element will increase. Moreover, glass area became small and the productivity of a liquid crystal display element was bad, so that the thickness of a glass plate became small. Furthermore, the thickness of a glass plate is standardized, and the glass plate of arbitrary thickness was not obtained, therefore thickness with the as desired thickness of a liquid crystal display element was not obtained in many cases.

[0004] On the other hand, when you did not need especially a thin liquid crystal display element and the thickness of a glass plate was large, with the reflected type positive liquid crystal display element, the problem that the shadow of the lighting section was conspicuous might arise. The cross section of a liquid crystal display element explains this point by drawing 2. The liquid crystal display element shown in this drawing is the same as the liquid crystal display element shown by drawing 1. In this drawing, 13 is a polarizing plate with the polarization shaft of X shaft orientations, and 14 is a reflected type polarizing plate with the polarization shaft of Y shaft orientations. The segment turns on the liquid crystal layer 12 by impressing voltage to the segment section [ can impress voltage now partially, for example, ] (predetermined portion of a liquid crystal layer) displaying by segment display. With a polarizing plate 13, light with the electric-field amplitude of X shaft orientations is chosen, and the light which carried out incidence from A passes a glass substrate 10, and it carries out incidence to the liquid crystal layer 12. Here, it is the voltage non-impressed section LC 1 of the liquid crystal layer 12. 90 degrees of light which carried out incidence are twisted in the case of passage, they turns into light with the amplitude of Y shaft orientations, passes a glass substrate 11, and reaches a polarizing plate 14. Since the polarization shafts of a polarizing plate 14 are Y shaft orientations, it is reflected, and the light which carried out incidence to the polarizing plate 14 here passes a glass substrate 11, and it carries out incidence to the liquid crystal layer 12. Since this incidence position is the voltage impression section LC 2 of the liquid crystal layer 12 (slash section), light passes as it is and reaches a polarizing plate 13. Since light has the amplitude of Y shaft orientations at this time and the polarization shafts of a polarizing plate 13 are X shaft orientations, light is cut, is seen from C and the lighting section LT looks black. Next, only the light which had the amplitude of X shaft orientations similarly carries out incidence of the light which carried out incidence from B to the liquid crystal layer 12. this incidence position -- the voltage impression section LC 2 of the liquid crystal layer 12 it is -- a sake -- light -- as it is -- the liquid crystal layer 12 and a glass substrate 11 -- passing -- a polarizing plate 14 -- reaching -- although -- light -- the liquid crystal layer 12 -- a little -- or -- twisting -- having . Since the polarization shafts of a polarizing plate 14 are Y shaft orientations, the light of X shaft orientations which have carried out incidence is cut, and looks black. However, the light of Y shaft-orientations component twisted by the liquid crystal layer 12 is reflected. This reflected light reaches the liquid crystal layer 12, and it is the voltage non-impressed section LC 3. 90 degrees is twisted, it becomes the light of X shaft orientations, and a polarizing plate 13 is reached, and since the polarization shafts of a

polarizing plate 13 are X shaft orientations, they are passed as it is. The light reflected by the polarizing plate 14 is weak, and Shadow SH is in sight and it serves as deterioration of the grace of a display from D.

[0005] this invention solves such a problem, and manufacture of a thin liquid crystal display element is easy, and it aims at offering the manufacture method of a liquid crystal display element that improvement in display grace can be aimed at.

[0006]

[Means for Solving the Problem] In order to attain the above-mentioned purpose, the manufacture method of the liquid crystal display element of this invention is the manufacture method of a liquid crystal display element of enclosing and making liquid crystal between the glass substrates of a couple, after sticking the aforementioned glass substrate in the state of having a liquid crystal enclosure interval, grinds at least one side of the aforementioned glass substrate, and is made to make it thin. And thickness of the glass substrate by the side of the tooth back among for example, the aforementioned glass substrates It is made to make it 0.3mm or less.

[0007]

[Function] If it does in this way, since the thickness of glass is large, the handling of a glass plate is easy for the process of the lamination of a glass substrate, and, moreover, it can use the present manufacturing installation. Moreover, by polish, since it is made to make board thickness of glass thin, manufacture of the liquid crystal display element of arbitrary thickness is attained. Furthermore, by making thin thickness of the glass substrate by the side of a tooth back, the shadow of the lighting section of a reflected type liquid crystal display element stops being able to be conspicuous easily, and display grace improves.

[0008]

[Example] Hereafter, the example of this invention is explained, referring to a drawing. The cross section of the liquid crystal display element which carried out this invention to drawing 3 is shown. The portion of the liquid crystal layer 12 is expanded and shown in this drawing. Thickness The 1.1mm glass substrates 10 and 11 are stuck in the state of having a liquid crystal enclosure interval, after processing of washing, formation of the pattern of a transparent electrode, etc. is performed respectively. Here, processing which grinds glass substrates 10 and 11 and makes board thickness thin by the wrapping grinding method etc. is carried out. Then, pouring of liquid crystal 12 is made and polarizing plates 13 and 14 are attached. Here, it is the board thickness of a glass substrate by polish. When it is made 0.3mm, the thickness T2 of a liquid crystal display element is. It is set to about 1.0mm and, moreover, this can be changed arbitrarily.

[0009] Another example which carried out this invention to drawing 4 is shown. It is a perspective diagram, (b) is a cross section, and (a) expands and shows the portion of a liquid crystal layer in (b). The number in drawing is the same as that of drawing 3 . Although the liquid crystal display element shown here is manufactured by method like drawing 3 , it grinds a glass substrate 11, i.e., the glass substrate by the side of a tooth back, and it is board thickness. It is what was set to 0.3mm, and the thickness T3 of a liquid crystal display element is at this time. It is set to about 1.8mm. The state of the lighting section LT in the reflected type positive liquid crystal display element which ground only the glass substrate by the side of a tooth back like drawing 4 , and was made thin, and Shadow SH is shown in drawing 5 . In this drawing, the position of the voltage impression to the liquid crystal layer 12 is the same as drawing 2 , and is LC2 (slash section). When drawing 5 was compared with drawing 2 and the reflected light is seen, the part and Shadow SH to which the glass substrate 11 is thin move to the right-hand side of drawing, and Shadow SH laps with the lighting section LT. The area of the shadow which is actually in sight by this becomes small compared with drawing 2 , therefore Shadow SH stops being able to be conspicuous easily.

[0010]

[Effect of the Invention] Since according to this invention a glass substrate is ground and it is made thin by the culmination of manufacture of a liquid crystal display element as explained above, the process till then can be performed using the present manufacturing installation. In that case, compared with using the glass plate of thin board thickness from the beginning, handling is easy and improvement in workability can be aimed at. And by polish, manufacture of the liquid crystal display element of arbitrary thickness is attained, small lightweight-ization of a liquid crystal display can be performed, and it can respond now to a wide range use. Moreover, in a reflected type liquid crystal display element, by making the glass substrate of the tooth-back section thin, the shadow of the lighting section stops being able to be conspicuous easily, and the performance of a display improves.

---

[Translation done.]



(19)

(11) Publication number:

0

(Generated Document.)

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: 04049372

(51) Int'l. Cl.: G02F 1/13

(22) Application date: 06.03.92

(30) Priority:

(43) Date of application publication: 28.09.93

(71) Applicant: CASIO COMPUT CO

(84) Designated contracting states:

(72) Inventor: TAKAHASHI JUN

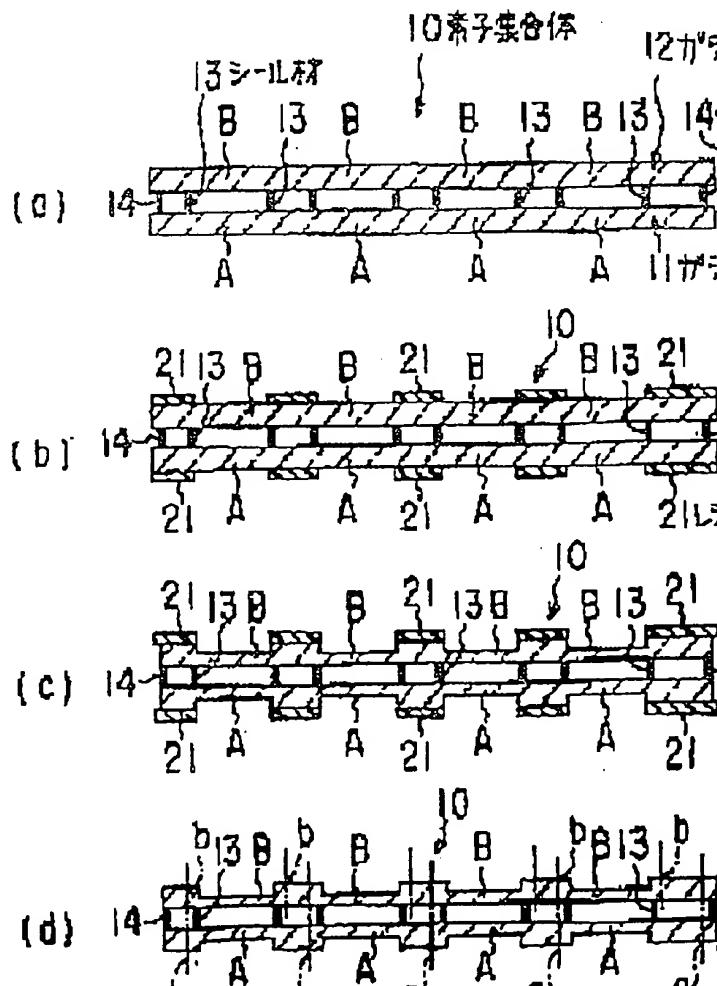
(74) Representative:

## (54) PRODUCTION OF LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT

(57) Abstract:

PURPOSE: To efficiently produce the liquid crystal display element which is reduced in the thickness of one substrate at a good yield.

CONSTITUTION: After a pair of glass substrates 11, 12 each having an area for plural pieces of liquid crystal display elements are adhered via sealing materials 13 respectively enclosing the liquid crystal sealing regions of the respective element blocks thereof and an outer peripheral sealing material 14 enclosing all of the respective element blocks to assemble an element assemblage 10. The outside surface of one of the two substrates 11, 12 of the respective element blocks is then etched exclusive of the peripheral edge parts of the element blocks to reduce the thickness of the parts exclusive of the peripheral edge parts of this substrate and thereafter, the element assemblage 10 is separated to the individual elements.



COPYRIGHT: (C)1993,JPO&amp;Japio

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-249423

(9P)

(43)公開日 平成5年(1993)9月28日

(51)Int.Cl.  
(G 02 F) 1/18

技術分類  
101

内記載番号  
8806-2K

F I

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数1(全9頁)

(21)出願番号 特願平4-49372

(22)出願日 平成4年(1992)3月6日

(71)出願人 00000143

カシオ計算機株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目6番1号

(72)発明者 高橋 翔

東京都八王子市石川町51番地の5 カシ  
オ計算機株式会社八王子研究所内

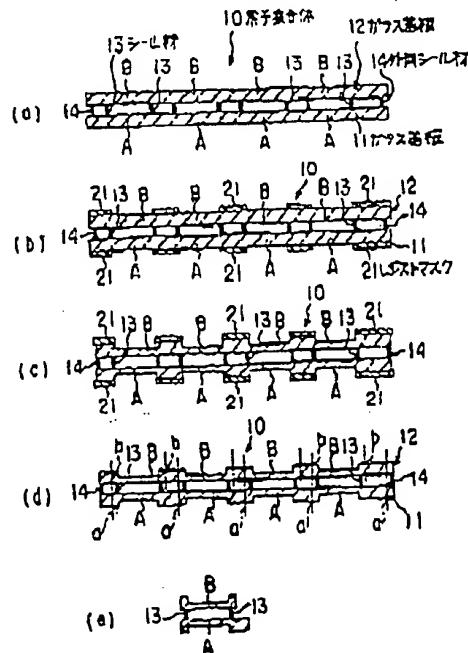
(74)代理人 弁理士 鈴江 武彦

(54)【発明の名称】 液晶表示素子の製造方法

(57)【要約】

【目的】少なくとも一方の基板の厚さを薄くした液晶表示素子を能率的にかつ歩留よく製造する。

【構成】液晶表示素子複数個の面積をもつ一対のガラス基板11、12を、その各素子区画の液晶封入領域をそれぞれ閉むシール材13と、前記各素子区画の全てを囲む外周シール材14とを介して接合して素子集合体10を組立てた後、前記各素子区画の両基板11、12のうち少なくとも一方の基板の外縁を前記素子区画の周縁部を除いてエッチングしてこの基板の前記周縁部を除く部分の厚さを薄くし、この後前記素子集合体10を個々の素子に分離する。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 液晶表示素子複数個分の面積をもつ一対のガラス基板を、その各素子区画の液晶封入領域をそれぞれ囲むシール材と、前記各素子区画の全てを囲む外周シール材とを介して接着して素子集合体を組立てた後、前記各素子区画の両枚のうち少なくとも一方の基板の外側を前記両区画の周縁部を除いてエッチングしてこの基板の前記周縁部を除く部分の厚さを薄くし、この後前記素子集合体を個々の素子に分離することを特徴とする液晶表示素子の製造方法。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は液晶表示素子の製造方法に関するものである。

## 【0002】

【従来の技術】 一般に、液晶表示素子は、複数個の素子を一括して同時に組立てる製法で製造されている。

【0003】 この製法は、液晶表示素子複数個分の面積をもつ一対のガラス基板の各素子区画にそれぞれ表示用の透明電極および遮光膜層を形成し、この一対の基板を、一方の基板にその各素子区画の液晶封入領域をそれぞれ囲んで印刷したシール材を介して接着して、複数個の液晶表示素子が並んだ素子集合体を組立てて、この後、この素子集合体の両基板を各素子区画ごとに分断して個々の素子に分離する方法であり、分離された各素子は、この後、前記シール材の一端に取付けておいた液晶注入入口から液晶封入領域に液晶を注入して前記液晶注入口を封止し、さらに素子の裏蓋面（両基板の外側）にそれぞれ偏光板を接着して液晶表示素子とされている。

【0004】 なお、液晶表示素子内に液晶を封入する方法には、一对の蓋板を接着する前に、一方の基板の各素子区画の液晶封入領域にそれぞれ適量の液晶をディスペンサ等によって滴下供給する方法もあり、この場合は、各素子区画の液晶封入領域を囲むシール材に液晶注入口を設けておく必要はない。

【0006】 ところで、液晶表示素子には、その背後にパックライトを配置して使用されるものと、素子の裏面に反射板を配置して使用される反射型のものがある。なお、前記反射板としては、透明な光拡散板の背面に光反射面を形成したもののが使用されている。

【0006】 上記反射型の液晶表示素子は、その裏面側反射板を通して入射し、両透鏡間の液晶層を通過した後、裏面側偏光板により逆走、反射されて像光となった光を、この裏面側偏光板の外側に配置した上記反射板で反射させて表示するもので、この反射型液晶表示素子は、時計、電卓、電子手帳等、各種電子機器の表示素子に広く利用されている。

【0007】しかし、上記反射型液晶表示素子は、反射板で反射された像光を素子の裏面側から観察するものであるため、表示を斜め方向から見ると、表示部が、明暗

と暗部との境界がぼけた線となってしまうという問題をもっている。

【0008】 これは、裏面側基板での光の屈折によるもので、反射型液晶表示素子の表示を裏面側（裏面側偏光板面）に対して垂直な方向から見た場合裏面側基板での光の屈折ではなく、したがって反射板で反射された反射光は入射時の経路と同じ経路を辿って出射するが、表示面に対して斜め方向から表示を見ると、裏面側基板での光の屈折によって、反射光の経路が入射時の経路からずれ、その結果、表示像の輪郭がぼけてしまう。

【0009】 このため、上記反射型液晶表示素子では、その両基板のうち少なくとも裏面側基板の厚さをできるだけ薄くすることが望まれており、裏面側基板の厚さを薄くすれば、表示を斜め方向から見たときにおける裏面側基板での光の屈折による反射光の経路のずれが小さくなるため、輪郭の鮮明な表示を得ることができる。

【0010】しかし、上述したように複数個の素子を一括して同時に組立てる製法で液晶表示素子を製造する場合は、液晶表示素子複数個分の面積をもつ大面積のガラス基板を用いるため、液晶表示素子の製造において最初から薄いガラス基板を使用したのでは、このガラス基板が、一对の基板をシール材を介して接着して素子集合体を組立てて際の基板加圧力に耐えきれずに割れてしまう。このため、上記製法で液晶表示素子を製造する場合は、薄くても0.3mm程度以上の厚さのガラス基板を使用する必要がある。

【0011】そこで、従来は、0.3mm～1.1mm程度の厚さのガラス基板を用いて素子集合体を組立て、この素子集合体を個々の素子に分離した後、各液晶表示素子のガラス基板の外側を機械的に研磨して、少なくとも一方の基板の厚さを薄くした液晶表示素子を製造している。

【0012】なお、この製造方法において、ガラス基板面の研磨を、素子集合体を個々の素子に分離してから行なっているのは、素子集合体の状態でガラス基板面を研磨すると、研磨中にガラス基板が割れてしまうからである。

## 【0013】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、上記従来の製造方法は、素子集合体を個々の素子に分離した後に、1つ1つの液晶表示素子についてそのガラス基板を薄く研磨するものであるため、液晶表示素子の製造工程が悪く、したがって液晶表示素子の良品率が高くなるという問題をもっていた。

【0014】しかも、上記従来の製造方法では、ガラス基板の外側を機械的に研磨してその厚さを薄くしているため、基板面の均一な研磨が難しく、そのためには複数化された基板の厚さにばらつきがあるし、また、研磨中に基板の角部が欠けたりして生じるガラス屑により基板面が傷ついて、この液晶表示素子が不良品となるため、液

品表示素子の製造歩留も悪いという問題があった。

【0015】本発明は上記のような実情にかんがみてなされたものであって、その目的とするところは、少なくとも一方の基板の厚さを薄くした液晶表示素子を能率的にかつ歩留よく製造することができる液晶表示素子の製造方法を提供することにある。

#### 【0016】

【課題を解決するための手段】本発明は、液晶表示素子複数個分の面積をもつ一つのガラス基板を、その各素子区画の液晶封入領域をそれぞれ囲むシール材と、前記各素子区画の全てを囲む外周シール材とを介して接着して素子集合体を組立てた後、前記各素子区画の両基板のうち少なくとも一方の基板の外側を前記各素子区画の周縁部を除いてエッチングしてこの基板の前記周縁部を除く部分の厚さを薄くし、この後前記素子集合体を個々の素子に分離することを特徴とするものである。

#### 【0017】

【作用】すなわち、本発明は、素子集合体の状態で各素子区画の両基板のうち少なくとも一方の基板の外側をエッチングすることにより、各液晶表示素子の少なくとも一方の基板の厚さを一括して薄くするものである。なお、この場合、素子集合体の内部は各素子区画の全てを囲む外周シール材によってシールされているため、基板外側のエッチングに際して素子集合体の内側がエッチング等因気にさらされることはなく、したがって、基板の内側がエッチングされてダメージを受けることはない。

【0018】そして、本発明では、素子集合体の状態で各素子区画の基板の厚さを薄くしているため、この後に素子集合体を分断して個々に分離される各素子は、その全てが既に基板の厚さを薄くされた素子であり、したがって、少なくとも一方の基板の厚さを薄くした液晶表示素子を簡便に製造できる。しかも、本発明では、基板外側をエッチングして基板の厚さを薄くしているために、基板を均一に薄くすることができるし、また機械的研磨のように基板を損傷してしまうこともないから、上記液晶表示素子を歩留よく製造することができる。

【0019】さらに、本発明では、各素子区画の基板の外側を各素子区画の周縁部を除いてエッチングすることにより、この基板の前記周縁部を除く部分の厚さを薄くしているため、この基板の周縁部に厚肉の縁部を残すことができ、したがって基板の厚さを薄くしても、その周縁部の強度を確保することができる。

#### 【0020】

##### 【実施例】

###### 【第1の実施例】

【0021】以下、本発明の第1の実施例を図1～図5を参照して説明する。図1は液晶表示素子の製造方法を示す各製造工程時の断面図であり、液晶表示素子は、次のような工程で製造する。

###### (工程1)

【0022】まず、図1(a)に示すように、液晶表示素子複数個分の面積をもつ一つのガラス基板11、12を、その各素子区画の液晶封入領域をそれぞれ囲むシール材13と、前記各素子区画の全てを囲む外周シール材14とを介して接着して素子集合体10を組立てる。

【0023】図2は上記素子集合体10の一部切開平面図であり、この素子集合体10は、後述する基板外側のエッティング工程を終了した後、両基板11、12を囲に一点銷線で示した分断線a、bに沿って折断することにより、個々の素子に分離される。

【0024】上記ガラス基板11、12は、素子集合体10の組立て時に割れ等を生じないような厚さ(約0.3mm～1.1mm)の基板であり、図1において下側の基板(以下、下基板という)11の分断線aで囲まれた各素子区画部分はそれぞれ液晶表示素子の表面側基板Aとなり、上側の基板(以下、上基板という)12の分断線bで囲まれた各素子区画部分はそれぞれ液晶表示素子の裏面側基板Bとなる。

【0025】そして、両基板11、12の各素子区画にはそれぞれ表示用の透明電極と配向膜とが形成されている。なお、図1および図2には透明電極および配向膜は示していないが、前記透明電極は、例えば図3に示すようなパターンの複数のセグメント電極15と、これらセグメント電極15に対応するコモン電極16(図4参照)であり、この実施例では、下基板11の全ての素子区画にセグメント電極15を形成し、上基板12の全ての素子区画にコモン電極16を形成している。また、図5および図4において、17、18は前記配向膜である。この配向膜17、18は、例えばポリイミドからなっており、その裏面にはラビング処理が施されている。

【0026】また、上記下基板11の各素子区画(液晶表示素子の裏面側基板A)の一側縁部は、液晶封入領域を囲むシール材13の外側に突出する端子配列部とされている。この端子配列部には、図3および図4に示すように、上記各セグメント電極15の端子15aと、上基板12に形成したコモン電極16の端子16aとが形成されており、上基板12側のコモン電極16は、素子集合体10を個々の素子に分離した後、シール材13の外側において逆電ベースト19等により下基板11に形成した端子16aと導通接続される。上記素子集合体10は、次のようにして組立てる。

【0027】まず、各素子区画にそれぞれ上記セグメント電極15と配向膜17とを形成した下基板11と、各素子区画にそれぞれ上記コモン電極16と配向膜18とを形成した上基板12とのうち、一方の基板面に、その各素子区画の液晶封入領域をそれぞれ囲むシール材13と、各素子区画の全てを囲む外周シール材14とを、スクリーン印刷法等によって同時に印刷する。なお、前記シール材13、14には、ガラス基板11、12とのエッティング選択性が高い接着剤(ニボキシ樹脂系接着剤

等)を用いる。また、各電子区画のシール材13はその一部に液晶注入口13aとなる隙間を残して印刷し、また外周シール材14はその一部に通気口14aとなる隙間を残して印刷する。

【0028】次に、上記一对のガラス基板11、12をその各電子区画を互いに対向させて重ね合わせ、この両基板11、12を前記シール材13、14を介して接着する。この場合、両基板11、12間の空間は、各電子区画のシール材13の一部に設けた液晶注入口13aと外周シール材14の一一部に設けた通気口14aとを介して外側に遮断しているため、両基板11、12間の空気圧が高くなることはなく、したがって、両基板11、12をその全周にわたって均一な間隔で接着することができる。

【0029】このようにして電子集合体10を組立てた後は、外周シール材14の一部に設けておいた通気口14aを、ガラス基板11、12とのエッチング選択比が高い封止材(エポキシ樹脂系接着剤等)20で封止し、電子集合体10の内部を密封する。

#### (工程2)

【0030】次に、図1(b)に示すように、上記電子集合体10の両基板11、12の外側にそれぞれ、各電子区画のシール材13で囲まれた液晶注入領域(液晶表示電子の表示領域)を除いて他の部分全体を覆うレジストマスク21を形成する。

#### (工程3)

【0031】次に、上記電子集合体10の両基板11、12の外側をエッチングして、その各電子区画部分、つまり液晶表示電子の裏側の基板A、Bとなる部分の厚さをその周縁部を除いて図1(c)に示すように薄くする。

【0032】この上基板12の外側のエッチングは、半蔵をベースとするエッティング液を用い、このエッティング液中に電子集合体10を浸漬して行なう。このように、電子集合体10をエッティング液に浸没すると、下基板11の各電子区画部分、つまり液晶表示電子の裏側基板A部の外側が、レジストマスク21で覆われている周縁部を除いてエッティングされるとともに、上基板12の各電子区画部分、つまり液晶表示電子の裏側基板B部の外側が、同様にレジストマスク21で覆われている周縁部を除いてエッティングされ、前記裏側基板A部および裏側基板B部の周縁部を除く部分(液晶注入領域に対応する部分)の厚さが徐々になって行く。なお、この基板11、12のエッチング時間は、最終的に得ようとする基板厚さに応じて設定すればよく、このエッティング時間を制御することにより、前記裏側基板A部および裏側基板B部の厚さを0.2mm~0.1mmまで薄くすることができる。

【0033】この場合、基板11、12は、エッティング液中において機械的な力がかからない状態でエッティング

されるため、電子集合体10の状態で基板11、12の厚さを薄くしても、この基板11、12に割れが発生することはないし、また基板11、12のエッチングは基板全体にわたって均等に進行するため、基板11、12のエッティング領域をその全域にわたって均一に薄くすることができます。

【0034】なお、電子集合体10をエッティング液中に浸漬しても、電子集合体10の内部は、各電子区画の全てを囲みかつ通気口14aを封止材19で封止した外周シール材14によってシールされているため、電子集合体10の内部がエッティング容積であるエッティング液にさらされることなく、したがって、基板11、12の内面がエッティングされてダメージを受けることはない。

【0035】また、この場合、基板11、12の外側エッティングを行なっている間に、この両基板11、12の外周面もエッティングされるが、両基板11、12の外周面が外周シール材14の内周面より内側に後退するまでは、電子集合体10内へのエッティング液の侵入が外周シール材14によって阻止されるから、外周シール材14を基板外周部からある程度の間隔をとって設けるとともに、この外周シール材14の幅を十分大きくとっておけば、両基板11、12の外周面がニッティングされても何等問題はない。

【0036】このように、電子集合体10の状態で基板11、12の外側をエッティングした後は、速やかに電子集合体10を洗浄し、電子集合体10に付着しているエッティング液を完全に除去し、この後、両基板11、12からレジストマスク21を剥離する。

#### (工程4)

【0037】次に、図1(d)に示すように、上記電子集合体10の両基板11、12を、上述した分断線8、9に沿って折断し、この電子集合体10を個々の電子に分離する。図1(e)は分離された1つの電子を示している。

#### (工程5)

【0038】この後は、分離した各電子の裏面側基板Bに形成されているコモン電極6と、表面側基板Aの端子配列部に形成してあるコモン電極端子6aとを、図3および附4に示したようにシール材13の外側において導電ペースト19等により接続するとともに、各電子内にシール材13の一部に設けておいた液晶注入口13aから真空注入法により液晶LCを注入して前記液晶注入口13aを図3に示すように封止材22で封止し、この後、電子の裏面側基板A、Bの外側にそれぞれ偏光板を接着するとともに、さらに裏面側の偏光板の外側に反射板を接着して、反射型の液晶表示電子を完成する。

【0039】図5は完成した液晶表示電子を示しており、偏光板23、24は、両基板A、Bの凹入面(エッティングにより厚さを薄くした部分の外側)にそれぞれ接着され、また反射板25は、裏面側偏光板24の外側に

接着されている。なお、前記反射板25は、透明な光拡散板の背面に光反射面を形成したものである。

【0040】この液晶表示素子は、表裏の基板A、Bの厚さを薄くしたものであるため、光の透過率が高いし、また表示を斜め方向から見たときにおける裏面側基板Bでの光の屈折による反射光の経路のずれが小さいため、鏡部の鮮明な表示を得ることができる。

【0041】また、この液晶表示素子では、両基板A、Bをそれぞれその周縁部を除いて薄くしているため、両基板A、Bの周縁部に、素子集合体10を組立てるときのガラス基板11、12の厚さ(約0.3mm~1.1mm)と同じ厚さの厚肉部があり、したがって、この厚肉部でA、Bの周縁部を補強することができるし、さらに裏面側基板Aの端子配列部も厚肉であるため、液晶表示素子をその駆動回路に接続する際に、液晶表示素子の端子配列部に圧力がかかっても、液晶表示素子が破壊されることはない。

【0042】そして、上記製造方法においては、素子集合体10の状態で各素子区画の両基板、つまり液晶表示素子の裏面側基板Aと裏面側基板B部の外側をニッティングすることにより、各液晶表示素子の両基板A、Bの厚さを一括して薄くしているため、この後に素子集合体10を分断して個々に分離される各素子は、その全てが既にその両基板A、Bの厚さを薄くされた素子であり、したがって、基板の厚さを薄くした液晶表示素子を専用的に製造することができる。

【0043】しかも、上記製造方法では、基板外側をニッティングして基板の厚さを薄くしているために、基板を均一に薄くすることができるし、また経済的研磨の上に基板を損傷してしまうこともないから、上記液晶表示素子の製造歩留りもよい。

【0044】さらに、上記製造方法では、各素子区画の基板(液晶表示素子の裏面側基板Aと裏面側基板B部)の外側を素子区画の周縁部を除いてエッチングすることにより、この基板の前記周縁部を除く部分の厚さを薄くしているため、この基板の周縁部に厚肉の部分を残すことができ、したがって基板の厚さを薄くしても、その周縁部の強度を確保することができる。

#### 【第1の実施例の変形例】

【0045】上記実施例では、液晶表示素子の両基板A、Bの周縁部はその全周にわたって厚肉のままとしているが、素子集合体10の状態での基板外側のエッチング部に、前記両基板A、Bの一方または両方の周縁部の外側も部分的にエッチング(この部分にはレジストマスク21を形成しない)すれば、基板周縁部の外側に他の部品の収容凹部を形成することができる。すなわち、図8および図7はそれぞれ上記第1の実施例の変形例を示す完成された液晶表示素子の電子機器裏蓋状態の断面図である。

【0046】図8に示した液晶表示素子は、その裏面側

基板Aの端子配列部とその反対側の縁部とに素子押え部材26の収容凹部を形成したもので、この変形例によれば、素子押え部材26を液晶表示素子の表面上に突出させることなく液晶表示素子を電子機器に実装することができる。なお、図6において、27は液晶表示素子の駆動回路を形成した回路基板、28は前記回路基板27と液晶表示素子の端子配列部との間に接続されて前記駆動回路の端子27aと液晶表示素子の端子とを接続する弹性コネクタである。

【0047】また、図7に示した液晶表示素子は、その裏面を逆にして使用されるものであり、反射板25は端子配列部を有する基板Aの外側に設けた偏光板23の外側に接続されている。そして、この液晶表示素子では、上記基板Aの端子配列部の外側に、液晶表示素子の駆動回路を形成した回路基板29上に取付けられている集積回路素子30を収容する凹部を形成している。この変形例によれば、回路基板29上に取付る集積回路素子30を液晶表示素子の端子配列部の下に配置できるし、また液晶表示素子を回路基板29から大きく離間させて実装する必要もないから、電子機器の薄型化をはかることができる。なお図7において、31は前記回路基板29上の端子29aと液晶表示素子の端子とを接続するフィルム状コネクタである。

#### 【第2の実施例】

【0048】なお、上記第1の実施例では、液晶表示素子の裏面の基板A、Bの厚さをそれぞれ薄くしているが、反射型液晶表示素子の表示を鮮明にするには、少なくとも反射板25を配置する裏面側の基板(図5および図6では基板B、図7では基板A)の厚さを薄くすればよいから、裏面側の基板は厚いままでよい。

【0049】このように反射板25を配置する裏面側の基板だけを薄くした液晶表示素子は、図8に示した第2の実施例によって製造することができる。なお、図8において、第1の実施例と対応するものには同符号を付し、重複する説明は省略する。

【0050】この実施例では、図8(a)に示すように素子集合体(第1の実施例の素子集合体と同じもの)10を組立てた後、図8(b)に示すように素子集合体10の両基板11、12のうち、液晶表示素子の裏面側基板Aとなる下基板11にはその外側全体を覆うレジストマスク21を形成し、裏面側基板Bとなる上基板11には各素子区画の液封入領域を除いて他の部分全体を覆うレジストマスク21を形成して、エッチング液中で基板外側をエッチングする。

【0051】このように、下基板11の外側全体をレジストマスク21で覆っておいて基板外側をエッチングすると、図8(c)に示すように、上基板12のレジストマスク21で覆われていない部分だけがその外側からエッチングされて薄くなる。この基板外側のエッチングを行なった後は、速やかに素子集合体10を洗浄し、この

後面基板11、12からレジストマスク21を剥離する。

【0052】この後は、図8(d)に示すように、上記電子集合体10の両基板11、12を、分断線a、bに沿って折断し、この電子集合体10を個々の電子に分離する。図8(e)は分離された1つの電子を示しており、この電子の表面側基板Aはその全体が電子集合体10の組立て時に用いたガラス基板の厚さのままであり、裏面側基板だけがその周縁部を除いて薄くなっている。

【0053】なお、この電子は、第1の実施例と同様に、裏面側基板Bの電極と表面側基板Aの端子配列部に形成してある端子とをシール材13の外側において導電ペースト等により導通接続し、内部に液晶L.Cを注入して液晶注入入口13aを封止し、この後、両基板A、Bの外側にそれぞれ偏光板を接着するとともに、裏面側偏光板の外面に反射板を接着して、反射型の液晶表示電子される。

#### 【第3の実施例】

【0054】なお、第1および第2の実施例では、全ての電子区画に液晶表示電子の裏面側基板に設ける電極(セグメント電極)と裏面側基板の電極の端子を形成した基板11と、全ての電子区画に液晶表示電子の裏面側基板に設ける電極(コモン電極)を形成した基板12とを用いて電子集合体10を組立て、その一方の基板の厚さを薄くしているが、上記電子集合体10は、1つおきの電子区画に液晶表示電子の裏面側基板に設ける電極と裏面側基板の端子を形成し、他の電子区画に裏面側基板に設ける電極を形成した一対のガラスを用いて組立ててもよい。

【0055】すなわち、図9および図10は本発明の第3の実施例を示しており、この実施例は、表面側基板は薄くせず、裏面側基板だけを薄くした液晶表示電子を製造する例である。図9は液晶表示電子の製造方法を示す各製造工程時の断面図、図10は電子集合体10の一剖面図である。なお、図9および図10において、第1および第2の実施例と対応するものには同符号を付し、重複する説明は省略する。

【0056】まず、電子集合体10の構成を説明すると、この電子集合体10は、図9(a)および図10に示すように、1つおきの電子区画に液晶表示電子の裏面側基板に設ける電極と裏面側基板の電極の端子を形成し、他の電子区画に裏面側基板に設ける電極を形成した一対のガラス11、12を、その各電子区画の液晶封入部をそれぞれ囲むシール材13と、前記各電子区画の全てを囲む外周シール材14とを介して接着して組立てたものであり、この電子集合体10は、後述する基板外側のエッティング工程を終了した後、両基板11、12を図に一点継線で示した分断線a、bに沿って折断することにより、個々の電子に分離される。

【0057】上記ガラス基板11、12は、電子集合体

10の組立て時に割れ等を生じないような厚さ(約0.3mm~1.1mm)の基板であり、下基板11の分断線aで囲まれた各電子区画部分のうち、1つおきの区画部分はそれぞれ液晶表示電子の裏面側基板Aとなり、他の区画部分はそれぞれ液晶表示電子の裏面側基板Bとなる。また、上基板12の分断線bで囲まれた各電子区画部分のうち、下基板11の裏面側基板A部に対向する区画部分はそれぞれ液晶表示電子の裏面側基板Bとなり、下基板11の裏面側基板B部に対向する区画部分はそれぞれ液晶表示電子の裏面側基板Aとなる。

【0058】そして、図示しないが、両基板11、12の各電子区画のうち、裏面側基板A部にはそれぞれ液晶表示電子の裏面側基板に設ける表示用の透明電極と配向膜とが形成されており、裏面側基板B部にはそれぞれ液晶表示電子の裏面側基板に設ける表示用の透明電極と配向膜とが形成されている。

【0059】また、両基板11、12の裏面側基板A部の一側隣部は、液晶封入部を囲むシール材13の外側に突出する端子配列部とされている。この端子配列部には、裏面側基板の電極の端子が形成されており、前記裏面側基板B部の電極は、電子集合体10を個々の電子に分離した後、シール材13の外側において導電ペースト等により裏面側基板A部の端子と導通接続される。

【0060】この実施例による液晶表示電子の製造方法を説明すると、この実施例では、まず図9(e)および図10に示した電子集合体10を組立てた後、図9(b)に示すように、両基板11、12の外面にそれぞれ、その各電子区画のうちの表面側基板A部の全周と裏面側基板B部の周縁部(電子区画の周縁部)とを覆うレジストマスク21を形成する。

【0061】次に、上記電子集合体10をエッチング液中に浸漬して、電子集合体10の両基板11、12の各電子区画のうち、レジストマスク21で覆われていない部分外面をエッティングし、両基板11、12の前記裏面側基板B部の厚さをその周縁部を除いて図9(c)に示すように所望の厚さに薄くする。この基板外側のエッティングを行なった後は、適やかに電子集合体10を洗浄し、この後両基板11、12からレジストマスク21を剥離する。

【0062】次に、図9(d)に示すように、上記電子集合体10の両基板11、12を、分断線a、bに沿って折断し、この電子集合体10を個々の電子に分離する。図9(e)は分離された1つの電子を示している。

【0063】この後は、第1の実施例と同様に、分離した各電子の裏面側基板Bに形成されている端子と裏面側基板Bの端子配列部に形成してある端子とを、シール材13の外側において導電ペースト等により導通接続するとともに、各電子内に真空注入法により液晶L.Cを注入して液晶注入入口13aを封止し、この後、電子の裏面側(両基板A、Bの外側)にそれぞれ偏光板を接着すると

ともに、さらに裏面側の偏光板の外側に反射板を接着して、反射型の液晶表示素子を完成する。

【0064】この実施例においても、素子集合体10の状態で各素子区画の周基板、つまり液晶表示素子の表面側および裏面側基板A、Bとなる部分のうち、裏面側基板B部の外側をニッティングすることにより、各液晶表示素子の一方の基板の厚さを一括して薄くしているため、一方の基板の厚さを薄くした液晶表示素子を能率的に製造することができるし、また、基板外側をニッティングして基板の厚さを薄くしているために、基板を均一に薄くすることができるとともに、基板を損傷してしまうこともないから、上記液晶表示素子を歩留よく製造することができ、しかも、基板をその屈曲部を除いて薄くしているため、基板の厚さを薄くしても、その屈曲部の強度を確保することができる。

【0065】なお、この実施例では、液晶表示素子の裏面側基板Aの厚さは薄くしていないが、素子集合体10の状態での基板外側のチッティングに際して、基板11、12の裏面側基板A部の上のレジストマスク21も、裏面側基板A部の周縁部（素子区画の周縁部）だけを覆うように形成すれば、裏面側基板Aと裏面側基板Bとの両方の基板の厚さをその周縁部を除いて薄くした液晶表示素子を製造することができる。

#### 【他の実施例】

【0066】上記各実施例では、素子集合体10の状態での基板外側のエッティングを、素子集合体10をエッティング液中に浸漬して行なっているが、この基板外側のエッティングは、素子集合体10にエッティング液を散布して行なっても、またドライニッティングによって行なってよい。

【0067】また、上記実施例では、素子集合体10を個々の液晶表示素子に分離した後に、各液晶表示素子に液晶を注入しているが、この液晶は、一对のガラス基板1、2を接着して素子集合体10を組立てる前に、一方のガラス基板の各素子区画の液晶注入領域にディスペンサー等によって滴下供給してもよく、その場合は、各素子区画の液晶注入領域を囲むシール材3に液晶注入口を設けておく必要はない。

#### 【0068】

【発明の効果】本発明によれば、素子集合体の状態で各素子区画の周基板のうちの一方の外側をエッティングしてこの基板の厚さを薄くし、この後前記素子集合体を個々の素子に分離しているため、一方の基板の厚さを薄くした液晶表示素子を能率的に製造することができるし、また、基板外側をエッティングして基板の厚さを薄くしているために、基板を均一に薄くすることができるとともに、基板を損傷してしまうこともないから、上記液晶表示素子を歩留よく製造することができ、さらに、各素子区画の周基板の外側を素子区画の周縁部を除いてエッティングすることにより、この基板の前記周縁部を除く部分の厚さを薄くしているため、基板の厚さを薄くしても、その周縁部の強度を確保することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例による液晶表示素子の製造方法を示す各製造工程時の断面図

【図2】図1(a)に示した素子集合体の一節切開平面図。

【図3】上記素子集合体から分離された液晶表示素子の液晶封入後の状態の一部切開平面図。

【図4】図3のIV-IV線に沿う断面図。

【図5】完成された液晶表示素子の断面図。

【図6】本発明の第1の実施例の変形例を示す完成された液晶表示素子の電子機器実装状態の断面図。

【図7】本発明の第1の実施例の他の変形例を示す完成された液晶表示素子の電子機器実装状態の断面図。

【図8】本発明の第2の実施例による液晶表示素子の製造方法を示す各製造工程時の断面図。

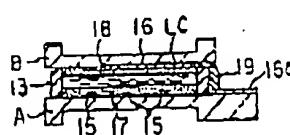
【図9】本発明の第3の実施例による液晶表示素子の製造方法を示す各製造工程時の断面図。

【図10】図9(a)に示した素子集合体の一節切開平面図。

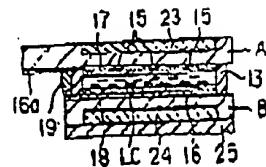
#### 【符号の説明】

10…素子集合体、11、12…ガラス基板、A…裏面側基板、B…裏面側基板、13…シール材、14…外周シール材、21…レジストマスク。

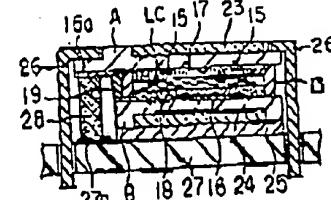
【図4】



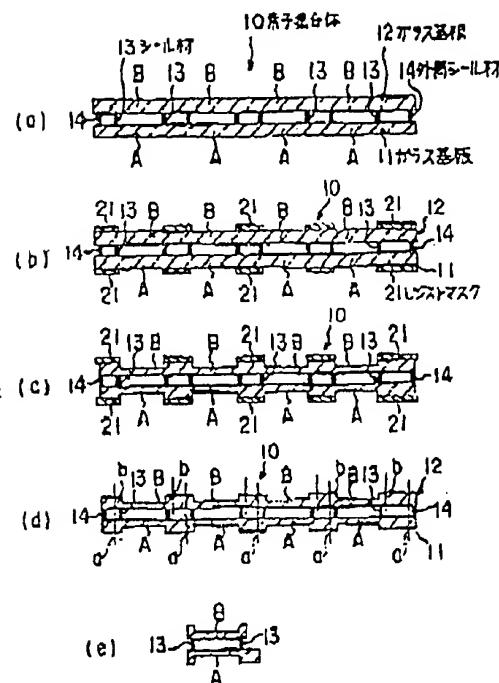
【図5】



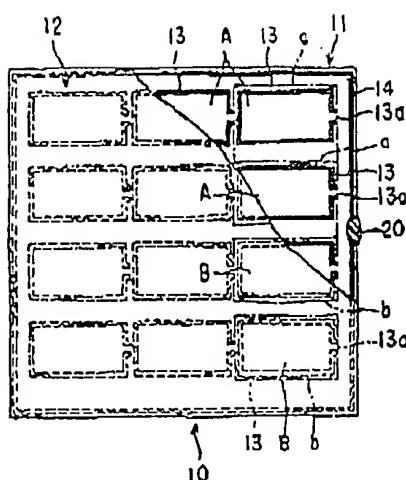
【図6】



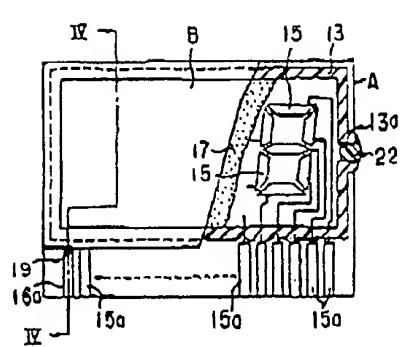
[図1]



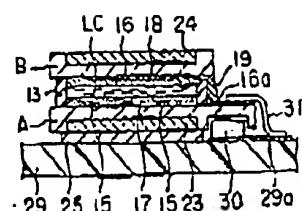
[図2]



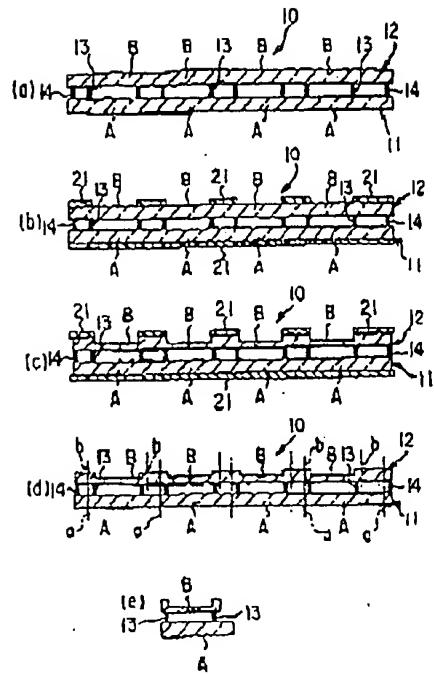
[図3]



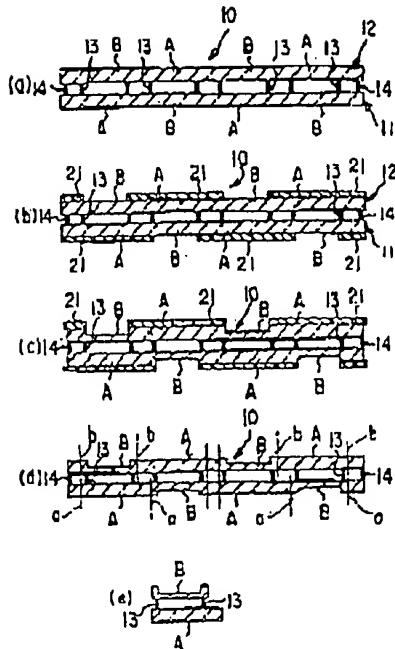
[図7]



〔図8〕



〔図9〕



〔図10〕

